

## Wireless Congress : Systems & Applications 2018

### List of attendees incl. Sponsors

AEC	ON Semiconductor Germany GmbH
Airbus Operations GmbH	openSynergy GmbH
ALCIOM	OpenSynergy Inc.
Alfred Kärcher SE & Co. KG	OpenWeightless CIC Limited
ANSYS Germany GmbH	Orderman GmbH
AR Deutschland GmbH	Packwise GmbH
Arendi AG	PcVue GmbH
Argus-Spectr	PER PELLENC
AWR Corporation	Petermann-Technik
Balluff GmbH	perisens GmbH
Baumer Hübner GmbH	PMO
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG	Popovic Consulting
Belimo Automation AG	Proant AB
Bluetooth SIG	Qorvo Utrecht B.V.
Bluetooth SIG Inc.	Robert Bosch GmbH
CM Heim GmbH	Salzburg Research
Code Mercenaries GmbH	Schildknecht AG
Code Mercenaries Hard- und Software GmbH	Schindler Digital Group Ltd.
COMICON	SEI ANTech-Europe GmbH
CommSolid GmbH	Semtech Germany GmbH
Conti Temic microelectronic GmbH	SEMTECH Neuchatel Sarl
CoreNetIX GmbH	Sensata Technologies
CTC advanced	Sewedy Electrometer
Daimler AG	SEW-Eurodrive GmbH & Co KG
DATALOGIC SRL	Sick AG
DECT Forum	Sierra Wireless
Deggendorf Institute of Technology	Sigfox Germany
Deutsches Patent- und Markenamt	Silicon Labs
Dialog Semiconductor B.V.	SILVAIR
Dr. Robert Conradt Mess- und Regeltechnik	SMK Corporation Japan
DSPG Technologies GmbH	SMK Electronics USA and Europe
EAO AG	SMK Europe
Eaton Industries GmbH	SOLTEC
EETechnologies Inc.	Sonceboz SA
EFO Ltd.	Sphinx Electronics GmbH & Co KG
Element Materials Technology	Stackforce GmbH
EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG	steute Technologies GmbH & Co. KG
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.KG	STMicroelectronics Application GmbH
Endress+Hauser SE+Co. KG	Swissphone Wireless AG
EnOcean Alliance	Taoglas GmbH
EnOcean GmbH	Techem Energy Services GmbH

Enterprise IOT  
ERCO GmbH  
Ericsson  
ETRI  
Eurofins Product Service GmbH  
European Parliament  
FALCOM GmbH  
Festo AG & Co. KG  
Festo AG & Co.KG  
fischerAppelt, relations GmbH  
Fraunhofer IIS  
Fraunhofer IMS  
Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS  
Fraunhofer IPMS  
Fujitsu Components Europe B.V.  
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG  
GOI  
Günther Spelsberg GmbH & Co.KG  
Häfele Engineering GmbH & Co KG  
Helbling Technik GmbH  
HELLA GmbH & Co KGaA  
Hetech  
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Hochschule Luzern T&A  
Huawei Technologies Düsseldorf GmbH  
HY-LINE Communication Products Vertriebs GmbH  
IBIT Ambrosini UG  
IHS Markit  
IMBEL  
IMEC  
IMST GmbH  
Intedis GmbH & Co. KG  
IP500 Alliance e.V.  
IQRF Alliance  
JLT Mobile Computers  
Leica Geosystems AG  
Lenze Automation GmbH  
Linköping University  
Lufthansa Technik AG  
Marquardt GmbH  
Maxim Integrated  
MegiQ BV.  
mm1 Technology GmbH  
Neocortec A/S  
NewTec GmbH

Technische Universität Berlin  
Technische Universität Hamburg  
tekmodul GmbH  
Thermokon Sensortechnik GmbH  
Tridonic Jennersdorf GmbH  
Triptec HL UL  
T-Systems Multimedia Solutions GmbH  
TÜV International  
TÜV Rheinland  
TÜV Rheinland Consulting GmbH  
ubisys technologies GmbH  
ULE Alliance  
University of Applied Sciences Offenburg  
Vector Informatik GmbH  
VEGA Grieshaber KG  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Vodafone/TU Dresden  
VTT  
V-ZUG AG  
WEBER-HYDRAULIK GmbH  
Wiliot  
Wingu  
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG  
WSW Engineering Office Electronics  
ZHAW InES  
Zühlke Engineering GmbH  
ZUSE Institut  
ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.  
Z-Wave Alliance

\* Sponsors 2018